

2023日本东京半导体展览会

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 2023日本东京半导体展览会 |
| 公司名称 | 江苏日通国际展览有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市花桥镇绿地大道231弄8号楼405室、406室（注册地址） |
| 联系电话 | 13817103638 13817103638 |

产品详情

日本东京半导体展览会

SEMICON JAPAN

展会时间：2023年12月13日-12月15日

展会地点：日本东京有明国际展览中心

主办单位：日本国际半导体设备及材料协会（SEMI）办:日经BP社 电通

展会周期：一年一届

组展单位：上海贸升展览服务有限公司—日本展服务商

不参展人员，我司可提供组团观展服务，提供签证，机票，酒店，入场证办理等服务

另我司可代办日本签证（商务，旅游，三年多次，5年多次）材料简单，出签快

展会简介：

日本东京国际半导体电子元器件展览会Semicon

Japan是日本规模大、具影响力的类展览会之一。日本东京国际半导体电子元器件展览会Semicon

Japan是一个国际化的半导体专项展览会，由Semi举办，该展每年一届在东京举办。

日本向全球半导体制造业供应了三分之一的半导体设备和超过一半的材料。SEMICON Japan位于半导体供应链的核心位置，来自日本和其他地区的750多家参展公司云集于此，为您的技术挑战和业务成功展示创新的解决方案。

市场情况：

上世纪80年代，通过实施超大规模集成电路计划（VLSI），日本半导体产业获得了飞跃式发展，成为世界半导体产业强国之一。进入90年代后，日本半导体产业受到内部的体制弊端和外部的激烈竞争的挑战，发展速度明显趋缓，在全球半导体产业中的地位不断下滑。近年来，随着日本经济开始出现好转，半导体行业设备投资迅速增长，产业呈现复苏迹象。在2003年-2006年间，日本累计完成新设备投资310亿美元，占同期全球半导体设备投资总额的近1/4，截止到2007年10月，日本国内已建成12英寸生产线17条，12英寸芯片产能从2006年的27.2万片/月，到年底预计将扩充到42.9万片/月，同比增长约58%。

积极为半导体产业制定发展规划，是日本政府支持本国半导体产业发展主要的体现。从早期的超大规模集成电路计划（VLSI）、“超电子技术开发计划”到新一代半导体的研究计划“飞鸟计划”（ASUKA）、“未来计划”（MIRAL）（目前正在执行第二期）以及“SOC基础技术开发计划”（ASPLA），均反映了通过牵头、企业和研究机构参与，进行半导体关键基础技术研发，生产验证、推动工艺标准化的努力。

参展范围：

- 1、半导体设备和材料、集成电路、半导体分立器件、半导体照明、半导体设备；
- 2、半导体封装设备、半导体扩散设备、半导体焊接设备、半导体清洗设备、半导体测试设备、半导体制冷设备、半导体氧化设备、半导体激光设备等；
- 3、导体分立器件产品与应用技术等；
- 4、半导体光电器件；
- 5、光伏太阳能、多晶硅提纯及辅助设备、晶体硅电池及辅助设备、TFT—LCD设备；

6、电子元器件和组件、电子生产设备\SMT设备（SMT生产线shebao、辅助及检测设备、OKI系列产品、防静电设备）、微组装设备（粘片、键合、清洗、检测、封焊设备）、工业辅料、粘结于密封、涂敷材料、表面处理、润滑产品、焊接辅助材料等。